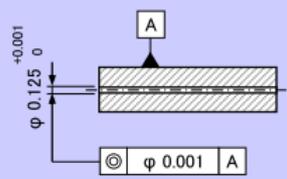
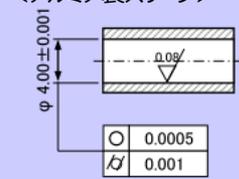
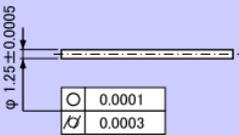
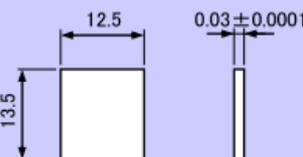
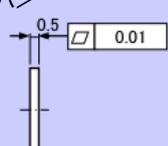


セラミックス加工

- (1) 切断技術
高精度のワイヤーソー切断及び微細切断方法を確立しております。
- (2) 研削技術
硬質脆性材料の真円度、円筒度、平面度をサブミクロン単位で加工することが可能です。
- (3) 研磨技術
平坦度や面粗度が求められる部品では、ナノメートル単位での加工が可能です。

単位(mm)

加工技術	加工素材	加工範囲 ※	特徴	実施例
穴加工 穴ポリシング	セラミックス ルビー 等	Φ0.07~Φ4.00 (±0.002)mm	穴径精度 ・寸法 ・同軸度 ・真円度 ・円筒度 ・穴内面粗さ	<p><ジルコニア製キャピラリ></p>  <p><アルミナ製スリーブ></p> 
外形加工 センターレス研削	セラミックス ルビー 等	Φ0.5~Φ10.0 (±0.001)mm	外形精度 ・寸法 ・真円度 ・円筒度	<p><ジルコニア製ピンゲージ></p> 
平面加工 平面ラップ 平面ポリシング	水晶 セラミックス ガラス 等	ウエハ厚み 0.03~0.1 (±0.002)mm (ウエハサイズ 10×10mmの時)	厚み寸法精度	<p><水晶ウエハ></p> 
切断加工 ワイヤーソー切断	水晶 ガラス	ウエハ厚み Φ0.1~10 (±0.005)mm (ウエハサイズ 20×20mmの時)	薄物で少切断代 平面度	<p><水晶ウエハ></p> 

※成形上りの寸法です。詳細は別途お問い合わせください。

シチズンファインデバイス株式会社